

2015年(平成27年)10月16日(金曜日)

日 刊



発行所 電波新聞社  
 東京本社  
 東京都品川区東五反田1-11  
 15 千141-8715  
 ◎03(3445)6111(大代表)  
 大阪本社  
 大阪府中央区北區3-2-25  
 (京阪淀屋橋ビル6階) 千541-0041  
 ◎06(6203)3361(大代表)  
 西 部 本 社  
 福岡市博多区博多駅前2-13  
 23(福岡ビル) 千812-0011  
 ◎092(431)7411(大代表)  
 ©電波新聞社 2006

千住金属工業

次世代はんだ付け材料量産

200度で可能な製品開発

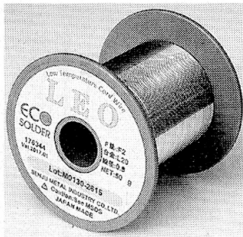
ポイド発生抑制の新シリーズも

千住金属工業は200度でのはんだ付けを可能にしたエコソルダコーアード「LEOシリーズ」と、新開発フラックスでポイドの発生を抑制したエコソルダペースト「GLVシリーズ」を開発、量産を開始した。

市場ニーズにマッチ

新製品は既にサンプル出荷し、市場ニーズにマッチして好評なことから本格販売を行う。

LEOシリーズは延性に劣り、硬くてもろいSn-Bi系合金、独自の加工技術や伸線技術を駆使し、やに入りはんだの製品化を行ったもの。低融点のフラックスも専用



「LEOシリーズ」

ビスマスが58%も入った難加工合金をワイヤ状にした製品は世界初となる。線径は0.8ミリの。

平山充芳営業一部部長は「市場はまだ小さいが、今後は耐熱性の低い基板や弱耐熱性部品が普及してきた時、低温はん



「GLVシリーズ」

ださが求められる。低温実装を先取りした弊社の技術の一つだ」と話す。同社は次世代の半導体

実装、SMTの開発に、目的や用途に応じた多種のソルダペーストをラインアップ。しかし市場はさらに高性能化、大電力化を要求。それに伴い、発熱量が増大するという課題が生じてきている。一般的に発熱量を抑える対策としては、発熱量を抑えるよりも基板や放熱パッドを介し熱を逃がす工夫がなされている。

放熱パッドや基板ははんだで接合されるが、はんだ付けした部分にポイドが生じると、良好な放熱性は得られない。

同社はポイドの発生を抑制するため、工法面からのアプローチと、絶縁抵抗値を維持しつつ活性化を上げ、濡れ性を強化

したフラックスを新開発、低温式のはんだ付けでもポイドの発生を激減させた。

パワー半導体実装向け

平山部長は「GLVシリーズを主流のペーストにしたい。市場としては車載、家電、モバイル、半導体パッケージなどに対応するが、特にパワー半導体実装用基板に適している」という。